

(1) With respect to the invention relating to claims 1, 2, and 4

In its opinion the applicant asserts that, as in this application, nothing is stated in cited references 1-7 concerning the dummy pattern covering roughly the entire surface of the part excluding the wiring pattern.

But wiring boards that have a conductor pattern over roughly their entire surface of the part excluding the wiring pattern have been well known since before the filing of this application, as shown for example in unexamined patent H11-040698 [1999] and unexamined patent H07-273243 [1995].

**拒絶査定**

特許出願の番号	特願 2000-016168
起案日	平成16年 3月12日
特許庁審査官	酒井 英夫 9631 4R00
発明の名称	回路基板
特許出願人	NECエレクトロニクス株式会社
代理人	渡辺 喜平

この出願については、平成15年12月18日付け拒絶理由通知書に記載した理由1によって、拒絶をすべきものである。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討したが、拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。

**備考****(1) 請求項1、2及び4に係る発明に対して**

出願人は意見書において、引用文献1-7には、本願の如くに、ダミーパターンが配線パターンを除いた部分のほぼ全面を覆うことについての記載がない旨主張している。

しかし、配線パターンを除いた部分のほぼ全面に導体パターンを設けた配線基板は、例えば、特開平11-040698号公報や特開平07-273243号公報等示された如くに、本願出願前より周知である。

このような周知の技術を引用文献1-5の何れかに記載の発明に対して適用することは、当業者であれば適宜になし得たものである。

また、引用文献6または7に記載の発明は、接続パッドの下方にダミーパターンが存在すれば、その目的を達成できるのであり、形状自体は当業者が適宜選択すべきものである。その形状として、前記した周知のパターンを採用することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

**(2) 請求項3に係る発明に対して**

出願人は意見書において、引用文献8には、ダミーパターンとダイの外周側壁部を、絶縁層を介して重なるように配置したことについての記載がない旨主張している。

しかし、配線パターンを除いた部分のほぼ全面に導体パターンを設けることは、(1)に示したとおり本願出願前より周知である。当該周知のパターンを引用文献8に記載の発明に対して適用することは、当業者であれば適宜になし得るものであるし、そのようなパターンを採用すれば、ダミーパターンとダイの外周側

壁部は、絶縁層を介して重なるように配置される構造を取らざるを得ない。

以上、(1)及び(2)により、平成15年12月18日付け拒絶理由通知書に記載した理由1は撤回しない。

なお、この査定に対して不服の審判を請求されるのであれば、その際の補正で付加できる事項は、この出願の出願当初の明細書または図面に記載した事項のほか、明細書または図面の記載から自明な事項に限られ、かつ、特許請求の範囲の限定的減縮、不明瞭な記載の釈明又は誤記の訂正を目的とする補正に限られることに注意されたい。また、審判請求の理由で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる当初明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張されたい。

---

上記はファイルに記録されている事項と相違ないことを認証する。

認証日 平成16年 3月15日 経済産業事務官 栗田 健志